

2020-2026年中国半导体市场深度评估与投资战略咨询报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国半导体市场深度评估与投资战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202006/169558.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

半导体产业起源地为美国，美国迄今仍在IDM模式（从设计、制造、封装测试以及投向消费市场一条龙全包）及垂直分工模式中的半导体产品设计环节占据绝对主导地位，而存储器、晶圆代工及封测等重资产、附加值相对低的环节陆续外迁。由于半导体属于技术及资本高度密集型行业，只有下游终端需求换代等重大机遇来临时，新兴地区通过技术引进、劳动力成本优势才有机会实现超越，推动产业链迁移。第一次半导体迁移发生在大型计算机时代，存储器制造环节由美国向日本转移。日本凭借规模化生产技术占据成本和可靠性优势，成为DRAM（动态随机存取存储器）主要供应国。此次迁移对上游带动作用明显，即便后期日本丧失存储器优势，迄今仍在上游原材料、设备领域占据领先地位。第二次半导体迁移发生在PC时代，PC对DRAM的诉求由可靠性转变为低价，韩国凭借劳动力优势取代日本的地位，至今仍主导存储器市场。与此同时，台湾首创垂直分工模式，逐步形成IC（集成电路）设计、晶圆代工、封测联动的产业集群。随着全球移动产品盛行、迭代速度更快，垂直分工模式以其更短的产品生命周期及更具竞争性的价格逐渐占据主导地位，长期引领全球晶圆代工、封测等环节。2015-2019年全球半导体细分市场规模及增速

2016销售额（亿美元）	2018E销售额（亿美元）	2018E销售额（亿美元）	2015增速（%）															
2016增速（%）	2018E增速（%）	2018E增速（%）		分立器件	186.12	193.99	199.52	206.03										
-7.7	4.2	2.9	3.3	光电器件	332.56	320.59	329.76	325.13	11.3	-3.6	2.9	-1.4		传感器				
88.16	108.10	117.46	123.47	3.7	22.6	8.7	5.1	集成电路	2744.84	2726.85	2814.26	2885.19						
-1.0	-0.7	3.2	2.5	模拟电路	452.28	473.79	497.03	513.78	1.9	4.8	4.9	3.4		微处理器				
612.98	627.19	634.40	647.54	-1.2	2.3	1.2	2.1	逻辑电路	907.35	882.86	906.99	923.79	-1.0					
-2.7	2.7	1.9		存储器件	772.05	743.01	775.85	800.07	-2.6	-3.8	4.4	3.1		合计	3349.68			

报告目录第一章半导体产业概述6第一节半导体产业定义6第二节半导体产业发展历程6第三

节半导体分类情况6第四节半导体产业链分析9一、产业链模型介绍9二、半导体产业链模型分析10第二章中国半导体产业发展环境分析11第一节中国经济环境分析11一、宏观经济11二、工业发展形势20三、固定资产投资分析22第二节半导体产业相关政策25一、国家“十三五”产业政策25二、其他相关政策26第三节中国半导体产业发展社会环境分析28第三章全球半导体市场分析29第一节全球市场发展概要29第二节全球主要国家发展情况302019年半导体分地区销售额增速一、美国30二、日本32三、韩国34四、欧洲34第三节国外重点厂商分析35第四章中国半导体产业供需现状分析39第一节半导体产业总体规模39第二节半导体产能概况40一、2014-2019年产量及规模40二、2020-2026年产量规模预测42第三节半导体市场需求概况42一、2014-2019年市场销售量及规模分析42中国半导体市场需求（亿元）二、2020-2026年市场需求量规模预测43第四节进出口分析44第五章中国半导体产业总体发展状况45第一节市场现状45一、市场概要45二、市场供需平衡度46三、消费特征47四、销售模式47第二节市场壁垒54第三节产业竞争结构分析55一、现有企业间竞争55二、潜在进入者分析55三、替代品威胁分析56第四节国际竞争力比较56第五节推动市场要素及阻碍因素57第六章2014-2019年我国半导体产业重点区域分析60第一节华北60第二节华南61第三节华东63第四节华中68第五节其它地区（西南、西北、东北）68一、部分企业概况68二、市场销售状况69第七章半导体产业市场分析70第一节重点产品70一、市场占有率70二、市场应用及特点70三、供应商分析71第二节技术分析74一、技术现状74二、创新技术研发及方向77第三节产品细分78第四节市场价格分析79第八章半导体国内典型企业80第一节中芯国际80一、简介80二、企业经营与财务状况分析80三、企业竞争优势分析80四、企业未来发展战略与规划81第二节上海新阳半导体材料股份有限公司81一、简介81二、企业经营与财务状况分析81三、企业竞争优势分析82四、企业未来发展战略与规划82第三节上海复旦83一、简介83二、企业经营与财务状况分析83三、企业竞争优势分析83四、企业未来发展战略与规划84第四节长电科技84一、简介84二、企业经营与财务状况分析84三、企业竞争优势分析85四、企业未来发展战略与规划86第五节银河半导体86一、简介86二、企业经营与财务状况分析86三、企业竞争优势分析87四、企业未来发展战略与规划88第九章2020-2026年半导体产业发展趋势及投资风险分析89第一节当前半导体市场存在的问题89第二节半导体未来发展预测分析89一、2020-2026年中国半导体产业发展规模89二、2020-2026年中国半导体产业技术趋势预测90三、总体产业“十三五”整体规划及预测90第三节2020-2026年中国半导体产业投资风险分析91一、市场竞争风险91二、原材料压力风险分析92三、技术风险分析92四、政策和体制风险95五、外资进入现状及对未来市场的威胁96图表目录：图表1半导体相关产业6图表2半导体元素7图表3国内半导体产业链结构10图表42014-2019年主要经济指标11图表52014-2019年中国进出口与国内消费状况12图表6中国货币供应、通货膨胀与经济增长变化情况12图表72014-2019年中国gdp增长的

拉动情况14图表82014-2019年全球主要发展中国家人均gdp变化趋势14图表92014-2019年各国服务业增加值占gdp比重情况14图表102014-2019年中国服务业就业占gdp比重15图表112010年以来中国体制改革与中国经济周期15图表122014-2019年中国经济目标与实际表现17图表132020-2026年各行业居民消费增长预测17图表142020-2026年中国消费率预测18图表15中国中学入学率仍比发达国家低19图表16未来十年新城镇化将推动中国消费需求20图表172014-2019年中国固定资产投资完成额累计同比（%）23图表182014-2019年固定资产投资完成额中央和地方项目累计同比（%）23图表192014-2019年中国基建投资拉动工业生产23图表202014-2019年国家预算内资金是主要来源24图表21房地产销售回升带动新开工回升24图表222014-2019年中国固定投资状况统计表24图表232014-2019年全球半导体市场规模与增长29图表242019年全球半导体市场产品结构29图表252014-2019年美国半导体月度销售额及增长率30

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202006/169558.html>